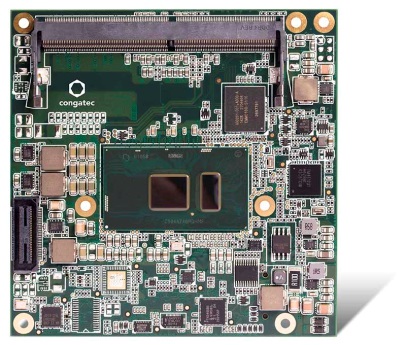
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

*  
Los nuevos módulos compactos COM Express de congatec con la sexta generación de procesadores Intel® Core™ (nombre en clave Skylake) han sido optimizados para sistemas sellados sin ventilación forzada con un TDP máximo configurable de 15 vatios.*

*Texto y foto también disponible online en::* <http://www.congatec.com/press>

Nota de prensa

**congatec presenta la nueva generación de módulos COM Express Compact con la sexta generación de procesadores Intel® Core™**

Nuevos niveles de rendimiento para sistemas integrados de 15 vatios sin ventilación forzada

**Deggendorf, 2 de Septiembre de 2015 \* \* \*** congatec AG, una empresa líder en tecnología de módulos informáticos integrados, ordenadores monoplaca (SBC) y servicios de diseño embebido y fabricación (EDM), ha presentado cuatro nuevos módulos compactos COM Express, al mismo tiempo en que se ha lanzado la sexta generación de procesadores Intel® Core™ (nombre en clave Skylake). Los nuevos módulos están especialmente diseñados para aplicaciones exigentes que requieren un alto rendimiento en diseños de sistemas sellados sin ventilación forzada. Cuentan con un TDP configurable de 15 vatios y están equipados exclusivamente con las ediciones ULV-SoC de bajo consumo basados ​​en la nueva microarquitectura de 14nm. En comparación con los módulos de 15 vatios con procesadores de quinta generación (nombre en clave Broadwell), los usuarios se benefician de las mejoras en los gráficos y el rendimiento de procesamiento, una mayor eficiencia energética y más alta velocidad en E / S.

Las aplicaciones típicas sin ventilación forzada los módulos compactos COM Express de congatec se pueden encontrar en visión industrial y médica, tecnología de salas centrales de control, terminales minoristas en planta, HMI, robótica, juegos profesionales, información y entretenimiento, AV profesional, videovigilancia inteligente, control autónomo de vehículo, alerta situacional asistida por ordenador, así como aplicaciones de señalización digital de alta gama. Sistemas de triple cabecera sin tarjeta gráfica, - por ejemplo, en superficies de comercio minorista y quioscos, donde los sistemas integrados controlan hasta tres cajeros independientes o máquinas expendedoras - presentan un ejemplo de mayor aplicación.

"Hemos fabricado los nuevos módulos compactos conga-TC170 COM Express al tiempo en que se lanzan los nuevos procesadores Intel Core, ya que nuestros clientes desean obtener la última tecnología del mercado lo más rápido posible", explica Gerhard Edi, Director de tecnología de congatec.

"Los nuevos módulos compactos de congatec nuevo fabricados con procesadores Intel Core de sexta generación proporcionan una excelente rapidez de cálculo y rendimiento de los gráficos, alta velocidad adicional de E / S para una mayor flexibilidad del sistema, y ​​una amplia gama de potencias, característica y opciones de rendimiento para satisfacer cualquier aplicación IoT", comenta Samuel Cravatta, Director de la línea de productos, grupo de Internet de las Cosas, Intel.

Los usuarios de los nuevos módulos informáticos se beneficiarán del alto nivel de estandarización y escalabilidad de los módulos COM Express combinados con una amplia documentación, implementaciones de control de grado industrial de congatec y un amplio soporte al cliente, que permite a los fabricantes de equipos integrar la última tecnología de procesador de forma rápida y eficiente en sus aplicaciones. Todos los módulos se ofrecen con disponibilidad a largo plazo y soporte de software de al menos siete años. El soporte de software incluye, por ejemplo, funciones de mayor seguridad, así como actualizaciones regulares UEFI / BIOS y parches BSP. Los clientes se benefician de un soporte fiable durante toda la vida útil de sus aplicaciones.

**Las innovaciones técnicas en detalle**

Los módulos conga-TC170, con COM Express Type 6, están equipados con las ediciones ULV-SoC de los procesadores Intel Core i3 / i5 / i7 de sexta generación. Por primera vez, ofrecen TDP configurable (Potencia de diseño térmico) de 7,5 a 15 vatios, lo que simplifica la correlación de la aplicación con el diseño térmico del sistema. La fuente de alimentación también se ha optimizado, lo que además de la nueva microarquitectura, también contribuye a la eficiencia energética y permite un turbo-boost mayor.

Otra nueva característica es el soporte de memoria rápida RAM de doble canal hasta 32 GB, que en la versión DDR4 ofrece mucho más ancho de banda y es mucho más eficiente que la versión DDR3.

Los gráficos integrados Intel Gen 9, que se estrenan con esta nueva microarquitectura, ofrecen funcionamiento independiente de hasta tres pantallas 4k con 60 Hz a través de DisplayPort 1.2. La versión 2.0 de HDMI también es compatible por primera vez, así como la versión de DirectX 12 para gráficos 3D basados en Windows 10 más rápidos. Ahora no sólo la decodificación, sino también la codificación de HEVC, VP8, VP9 y VDENC es compatible con el hardware. La transmisión energéticamente eficiente de vídeos de alta definición en ambas direcciones es posible por primera vez. Otras mejoras son el número de puertos USB 3.0 (ahora 4) SATA Gen 3 (ahora 3) PCIe Gen 3 (ahora 6), así como AMT (ahora versión 11.0).

Otras interfaces COM Express compatibles con 6 pines incluyen PEG, Gigabit Ethernet, 8x USB 2.0, LPC plus I²C y UART. Gracias a las interfaces de cámaras MIPI opcionales, también se pueden conectar directamente sensores de cámara CSI2. El soporte del sistema operativo se ofrece para todas las distribuciones de Linux y variantes de Microsoft Windows - incluyendo Microsoft Windows 10. Opciones de diseño simplificado extraordinarias, tales como disipadores de calor, placas carrier y kits de iniciación, así como módulos de gestión SMART Battery - completan la oferta de congatec.

A continuación se describen las versiones de CPU disponibles:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesador |  | Núcleos /  Hilos |  | Smart Cache |  | Frecuencia |  | Turbo Boost |  | TDP/ cTDP |  | Gráficos |  | AMT |
| Intel® Core™  i7-6600U |  | 2/4 |  | 4 MB |  | 2.6 GHz |  | 3.4 GHz |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1050 MHz |  | 11.0 |
| Intel® Core™  i5-6300U |  | 2/4 |  | 3 MB |  | 2.4 GHz |  | 3.0 GHz |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1000 MHz |  | 11.0 |
| Intel® Core™  i3-6100U |  | 2/4 |  | 3 MB |  | 2.3 GHz |  | - |  | 15/7.5 W |  | GT2 520 300-1000 MHz |  | - |

Disponen de hojas de datos con información adicional acerca de los nuevos módulos informáticos conga-TC170 en: <http://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-tc170.html>